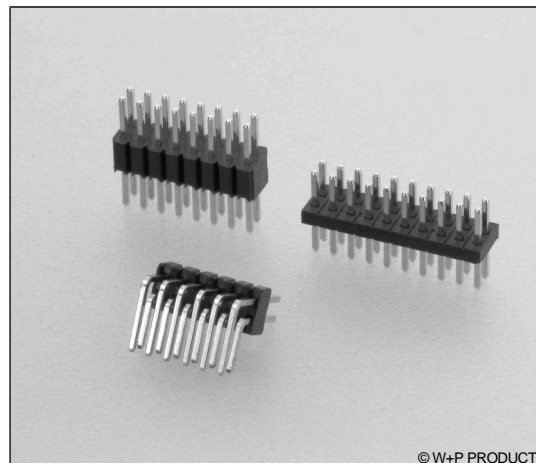


Stiftleisten RM 1,27mm, 2-reihig – 1,0 / 1,6 / 2,5mm Isolierkörper Pin Headers, 1.27mm Pitch, Double Row – 1.0 / 1.6 / 2.5mm Body

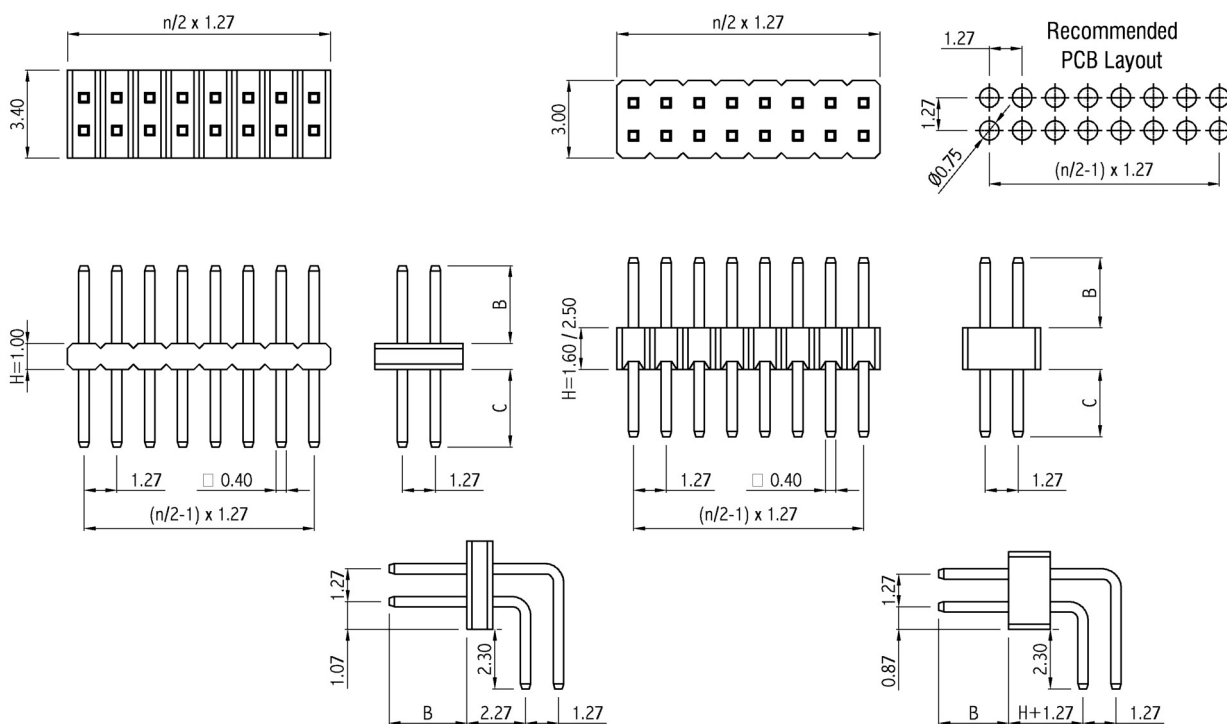
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,40mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.40mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
605 713 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series	Height*	Contacts*	Type*	Dimensions*	Plating*
712	1	008	1	20	60
	1 H=1,00mm 2 H=1,60mm 4 H=2,50mm	004-100 Zweireihig Double row	1 Gerade Straight 2 Gewinkelt Right-angled	Gerade: Straight: 10 B=2,70 C=2,60mm 20 B=3,00 C=3,00mm 99- Kundenspez. (Bmax=15mm) Customer-specific (Bmax=15mm) Gewinkelt: Right-angled: 10 B=3,05mm 20 B=1,91mm 99- Kundenspez. (Bmax=15mm) Customer-specific (Bmax=15mm)	00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

